



ABOUT US

☐ 中心介紹 Introduction

日月光於101年雙方簽訂產學合作意向書，擴展科研合作計畫，並捐助成大設立「日月光講座」，表揚對半導體封裝領域研究成果卓越之學者，以致力提昇半導體封裝產業技術。在之後的10多年，合作領域橫跨封裝、環保、智慧製造等不同專業，於110年加入智慧半導體與永續製造學院，積極進行科研合作計畫，更於113年成立聯合研發中心。

☐ 推動項目 Collaborative Projects

- 建構前瞻基礎技術
- 放大瞻基礎技術、落實產業應用
- 人才培育

☐ 發展方向 Development Direction

- 先進封裝
 - HPC封裝技術
 - Ai封裝技術
 - 矽光子封裝技術
 - 異質整合封裝技術
- 能源管理
 - 提升能源效率技術
 - 低碳材料技術
 - 永續能源技術